

日月光一〇三年度第四季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 104 年 2 月 6 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇三年度第四季及全年獲利報告，本公司一〇三年第四季之合併營業收入較一〇三年第三季成長 15%，較一〇二年同期成長 19%，為新台幣 76,644 百萬元。茲將日月光一〇三年度第四季單季及全年之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第四季	103 年度 第三季	102 年度 第四季	103 年度 全年	102 年度 全年
營業收入淨額	76,644	66,632	64,164	256,591	219,862
營業毛利	16,393	14,198	12,510	53,540	42,814
營業淨利（淨損）	9,817	8,084	6,939	29,571	22,044
稅前淨利（淨損）	9,550	8,590	5,792	28,474	19,357
所得稅利益（費用）	(1,470)	(1,237)	(450)	(4,252)	(3,202)
非控制權益	(224)	(148)	(134)	(629)	(466)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,856	7,205	5,208	23,593	15,689
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.99	0.82	0.66	2.95	2.03

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	103 年度 第四季	103 年度 第三季	102 年度 第四季	103 年度 全年	102 年度 全年
營業收入淨額	43,884	42,211	37,900	159,712	143,322
營業毛利	13,754	12,073	10,448	44,658	35,041
營業淨利（淨損）	8,905	7,348	6,149	26,436	19,011
稅前淨利（淨損）	9,261	8,366	5,654	27,444	18,397
所得稅利益（費用）	(1,340)	(1,105)	(405)	(3,662)	(2,547)
非控制權益	(65)	(56)	(41)	(189)	(161)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	7,856	7,205	5,208	23,593	15,689
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.99	0.82	0.66	2.95	2.03

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	58
電腦	11
汽車及消費性電子	31
其它	0
前十大客戶佔營收比重	56

銷售地區別佔比	%
北美	65
歐洲	9
台灣	16
日本	5
亞洲其它地區	5

封裝業務產品組合	%
Advanced Packaging	38
IC Wirebonding	53
Discrete and Others	9
封裝資本支出金額	65 百萬美元
打線機台數	15,792 台

測試業務產品組合	%
後段測試	75
晶圓測試	21
前段測試	4
測試資本支出金額	26 百萬美元
測試機台數	3,267 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	67
電腦	13
消費性電子	7
工業用	8
汽車電子	5
其它	0
前十大客戶佔營收比重	88
EMS 資本支出金額	55 百萬美元

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2015 年第一季的業績展望如下：

- 半導體封測事業之整體產能及平均單價將持平，整體產能利用率將降低約 10-15%；
- 電子代工服務第一季營運之變動情形將與去年同期相當；
- 合併營業毛利率及合併營業淨利率將接近去年同期之水準。